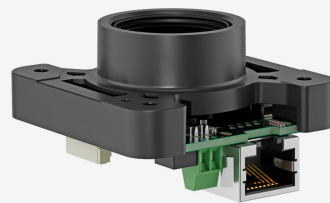
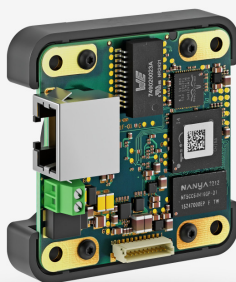
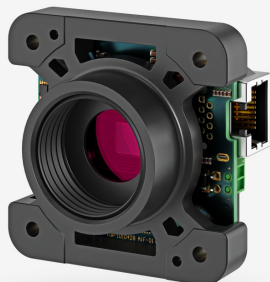


■ 量産中

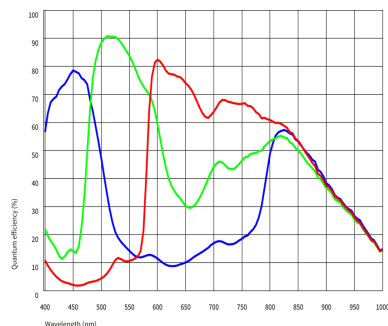
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	ローリングシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	13 MP
有効画素数	12.62 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	3552 x 3552 ピクセル
アスペクト比	1:1
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/1.6"
撮像面積	7.104 mm x 7.104 mm
光学センサーの対角	10.05 mm 1/1.6"
画素サイズ	2 μm
CRA (主光線角)	12 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX676-AACR1-C
ゲイン (マスター/RGB)	31.6x/16x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	2 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 平均 / 垂直: 平均
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング) 水平	-
デシメーション(サブサンプリング) 垂直	-
デシメーション(サブサンプリング) 手法	M/C 自動
デシメーション(サブサンプリング) 係数	-



モデル

フレームレートフリーランモード	9.9 fps
フレームレートトリガー（連続）	9.9 fps
フレームレートトリガー（最大）	14 fps
露出時間（最小～最大）	0.037 ms - 1999 ms
長時間露出（最大）	119977 ms
消費電力	2.5 W - 4 W
画像メモリ	128 MB

HDR

モード	ClearHDR
-----	----------

環境条件

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 90 ° C / 32 ° F - 194 ° F
動作時の許容周囲温度	0 ° C - 40 ° C / 32 ° F - 104 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	GigE RJ45
I/O コネクター	Wuerth 製 10 ピンコネクター（WR-WTB 1.00 mm）
電源	12 V ~ 24 V

ピン割り当て I/O コネクター

1	電源（VCC）、12 ~ 24 V
2	電源、接地
3	汎用入出力（GPIO）2、3.3 V - Line 3
4	汎用入出力（GPIO）1、3.3 V - Line 2
5	I2C SCL（信号クロック）3.3 V
6	I2C SDA（信号データ）3.3 V
7	オプトカプラなしのトリガー入力 3.3 V - Line 0
8	オプトカプラなしのフラッシュ出力 3.3 V - Line 1
9	接地（GND）
10	電圧出力 3.3 V、最大、100 mA



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	-
外形寸法	50.0 mm x 50.0 mm x 32.0 mm
重量	35 g
ハウジング素材	-

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	-
	Global start	-
フラッシュ	Flashing	-
	PWM flashing	-
画像調整	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
統合画像処理	Pixel formats	BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
その他	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	-
	Sequencer	-
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.60